

证券代码：601231
转债代码：113045

证券简称：环旭电子
转债简称：环旭转债

环旭电子股份有限公司

2025 年 10 月-11 月投资者关系活动记录

投资者关系活动类别	☒特定对象调研☐分析师会议 ☐媒体采访☐业绩说明会 ☐新闻发布会☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他
时间	2025 年 10 月 29 日-2025 年 11 月 14 日
地点	线下调研
上市公司 参会人员	史金鹏（董事会秘书）、冯超（证券事务代表）
参会机构名称	南方基金、鹏华基金、博时基金、景顺长城、嘉实基金、申量基金、平安基金、中信资管、天风证券、前海开源、国证资管、诺安基金、华创证券、安信基金、中欧基金、财通基金、兴全基金、中金公司、聚鸣投资、泰康资产、招商基金、中银证券、国泰海通资管、光大资产、万家基金、外贸信托、汇华理财、利位私募、国泰基金、信达澳亚基金、浦银安盛基金、华泰资产、东吴证券、金鹰基金、西部利得、东北证券、摩根基金、汇添富基金、华金证券
投资者提问	【Q&A环节】 【问题1】公司10月营收同比有一定下滑，具体是什么原因？ 【回答】公司10月营收下滑主要因公司通讯类产品销售主要采用buy&sell模式，公司承担物料采购，随着大客户新机上通讯类模组采用自研芯片，公司物料采购成本下降，进而导致单位售价和收入有所下降，该情形下公司单颗模组销售的毛利不受物料成本变动影响。 【问题2】北美厂商在9月发布新款眼镜后，相关产品热度较高，公司今年及明年眼镜的业务如何展望？ 【回答】公司在SiP领域公司基于硬件设计和测试开发上有扎实的基础，也建立了不同于竞争对手的技术优势。今年我们在新客户的SiP业务上看到了明显的业务进展，包括取得智能

	眼镜头部品牌客户的WiFi模组以及其主要份额的眼镜主板（MLB，main logic board）SiP模组业务。 具体而言，今年公司从8月开始有WiFi模组的量产出货；展望2026年，目前可以看到市场对客户眼镜产品的出货预期有较大上调，公司也将努力配合客户需求积极配置产能以实现客户的出货需求。在出货节奏上也有所加快，有机会能够在1月份甚至今年12月就开始量产出货MLB模组。2026年眼镜SiP模组出货上，会有一款主流机型搭载一颗MLB和一颗WiFi模组，另有一款机型会搭载WiFi模组。 展望未来，眼镜这个品类对“轻薄短小”的要求不同于其他消费类电子，这让我们看到在眼镜上更多SiP模组的应用机会，除了MLB和WiFi模组外，更多的如电源管理、音频、显示（RGB、光波导）、眼球追踪等以及控制手环中生物感测等都是SiP模组的应用机会。 我们目前新产品的开发需求旺盛，除了目前的眼镜客户外还有更多的头部客户的开发需求，使得我们能够在未来几年持续为头部客户提供方案和制造端上更多的价值；有别于EMS的业务模式，设计/开发/方案上提供更多价值的JDM模式也会有机会让我们利润率水平有所提升。此外，我们也将积极投入capex来服务头部客户的眼镜业务，以持续获得主要的市场份额。 【问题3】CSP厂商第三季度所给出的capex支出比较乐观，公司AI加速卡业务如何展望？ 【回答】我们在头部客户AI加速卡业务上增长较快，这部分业务增速会超过年初预期的150%，而在今年达到200%以上。同时，对照公司2026年的扩产计划，我们将在现有两条产线的基础，于2026年上半年新增两条产线，并视客户需求情况决定是否进一步增加产能，公司预计AI加速卡业务在2026年有望保持2025年的收入增速。 除了AI加速卡以外，我们也在加速提升智能制造的水平，客户对我们的交付能力相对满意，使得这部分业务的份额在2026年有所提升，基于我们与客户的稳定合作关系，相信未来1-2年内有很大机会向CSP厂商供应ASIC主板，从而进一步提升我们在AI服务器领域的业务范围和经营成果。 【问题4】介绍下公司布局光模块业务的最新进展 【回答】公司从2024年开始布局光模块业务，从自主研发设计开始，目的是要掌握产品设计的核心技术。今年三季度公司发布1.6T光模块的设计，采用主流的DR8架构，可以支持100m-500m的传输，并采用单模光纤，以确保资料传输的稳定性和可靠性。公司正在积极进行样品的测试以及送样，希望取得客户积极反馈并在明年Q4开始生产。 在光模块业务领域上，国内有很多的制造和技术，对公司来讲有很好的产业合作和整合
--	---

	的机会来加速公司在这项业务上的布局。目前公司在1.6T光模块上开发了两个设计方案，公司将积极落实工艺制程和产能方面的投资，希望尽快具备光模块完整的出货能力。 【问题5】公司的大客户在硬件端可以看到进入了一个创新周期，公司SiP模组的应用机会如何展望？ 【回答】我们向大客户供应的SiP模组可以看到每年都在迭代，也有新的SiP模组业务。大客户在消费电子上具有产品竞争力，AI目前也在逐渐导入。因此我们认为未来微小化模组的机会也会增长。具体而言，过去我们看到在手机里的电源管理和射频相关的器件是SiP模组应用的机会，今年大客户轻薄款的手机里就开始搭载了PMIC模组，预期明年的折叠机里也会搭载。同时，手机里的RF front-end module相关的整合、音频、应用处理、人脸识别等我们也看到了应用机会，相信公司在SiP模组业务上所积累的技术能力和开发经营能够让我们在智能手机内部功能系统模块和外部感测模块持续微小化的趋势中获益。 【问题6】公司出售控股子公司土地的进展如何，对公司损益影响如何？ 【回答】根据《关于拟出售控股子公司土地暨关联交易的公告》，公司拟向控股股东出售土地，交易金额折合人民币约1.75亿元，并产生资产处置收益折合人民币约1.45亿元（按照2025年6月25日汇率折算）。该交易已于近日完成交割，相关收益将计入公司第四季度财务报表。 【问题7】公司第三季度汽车电子类产品收入下滑较多，具体是什么原因？ 【回答】公司第三季度汽车电子类产品营业收入存在较多下滑，主要包括以下几个原因：1）公司第三季度将间接持有的控股子公司环强电子股份有限公司向公司间接控股股东出售，该公司主要业务为其2023年收购的泰科电子有限公司汽车无线业务，该子公司出售后相应导致公司汽车电子业务收入减少；2）公司汽车电子类业务受下游客户需求及其外包策略调整的影响，收入有所下滑，公司也相应在汽车电子类产品的业务策略上有所调整。
附件清单（如有）	无
日期	2025年11月14日